## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 6. Mai 2004 (06.05.2004)

### **PCT**

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/038068 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C23F 1/44, F01D 5/00

C23G 1/32,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/009235

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. August 2003 (20.08.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 02023394.6 18. Oktober 2002 (18.10.2002)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (71) Anmelder (nur für DE, FR, GB): OT OBERFLÄCHEN-TECHNIK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Werkstrasse 4, 19061 Schwerin (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): OTT, Michael

[DE/DE]; Hornhof 12, 45478 Mülheim an der Ruhr (DE). REICHE, Ralph [DE/DE]; Bulgenbachweg 15, 13465 Berlin (DE). COX, Nigel-Philip [GB/DE]; Gipsstrasse 23 B, 10119 Berlin (DE). MAIER, Uta [DE/DE]; Fritz-Reuter-Strasse 40, 19053 Schwerin (DE). ZIM-MER, Ronald [DE/DE]; Burgstallstrasse 17b, 90587 Obermichelbach (DE).

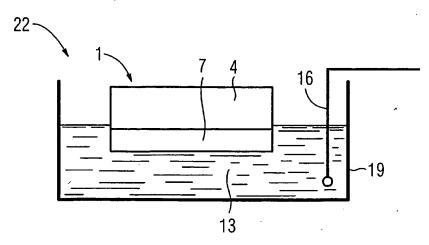
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, ŞE, SI, SK, TR).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD FOR REMOVING A LAYER AREA OF A COMPONENT
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ENTFERNEN EINES SCHICHTBEREICHS EINES BAUTEILS



- (57) Abstract: Prior art methods for removing a layer area of a component (stripping) lead to poor results since a removal, for example, ensues in a nonuniform manner. In addition, these prior art methods are time intensive. An inventive method for removing a layer area of a component consists of firstly treating the layer areas to be removed with a salt solution and then with acid, whereby in an intermediate or final step, the component is treated with a complexing agent.
- (57) Zusammenfassung: Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs eines Bauteils nach dem Stand der Technik (Stripping) führen zu schlechten Ergebnissen, da ein Abtrag beispielsweise ungleichmässig erfolgt. Ausserdem sind die bekannten Verfahren zeitintensiv. Ein erfindungsgemässes Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs eines Bauteils beinhaltet, dass die zu entfernenden Schichtbereiche zuerst mit einer Salzlauge und dann mit Säure behandelt werden, wobei das Bauteil in einem Zwischenoder Endschritt mit einem Komplexbildner behandelt wird.

